# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-171950

(43)Date of publication of application: 02.07.1996

(51)Int.CI.

HO1R 9/09

H05K 1/18

(21)Application number: 06-313258

(71)Applicant: MITSUBISHI

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

16.12.1994

(72)Inventor:

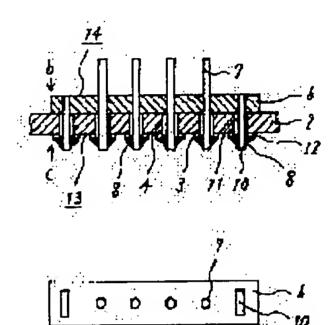
TATEISHI ATSUHIKO

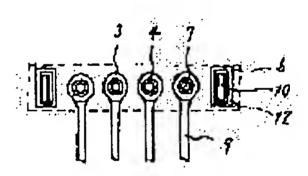
# (54) CONNECTOR DEVICE FOR PRINTED BOARD

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To relieve a connector terminal from heat cycle stress by fixing a reinforcing pin with a larger cross section that the connector terminal on both outside of the connector terminal and soldering the reinforcing pin through a printed wiring board to a land.

CONSTITUTION: When a printed board connector 14 is combined with a printed wiring board 13 and a connector terminal 7 is fitted in a throughhole 4, a reinforcing pin 10 is passed through the throughhole 11. Then, in conjunction with the terminal 7 to be soldered, a land 12 is soldered to the end of the reinforcing pin 10. In this way, stress on a solder fillet 8 due to a different thermal expansion coefficient between the connector board 6 and the printed board base material 2 is more toward both ends of the connector, but it is absorbed by the solder fillet 8 of the pin 10 with a larger cross section. The terminal 7 is thus relieved from stress.





#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

# (19) [[本四特許庁(JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公別番号

# 特開平8-171950

(43)公開日 平成8年(1996)7月2日

(51) Int.Cl.°			
	0100		

做別記号 广内整理番号

Z 6901-5B

FΙ

技術表示箇所

H01R 9/09 H05K 1/18

U 8718-4E

C 8718-4E

# 審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 5 頁)

(21)	ж	四五十

(22) 出版日

# 特願平6-313258

# 平成6年(1994)12月16日

## (71)出顧人 000006013

三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

(72)発明者 立石 厚彦

長崎市丸尾町6番14号 三菱電機株式会社

長崎製作所内

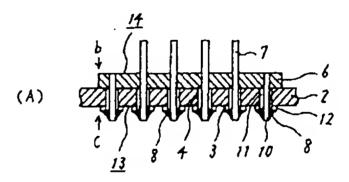
(74)代理人 弁理士 高田 守 (外4名)

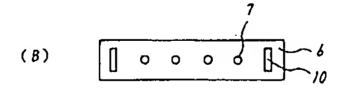
## (54) 【発明の名称】 プリント基板用コネクタ装置

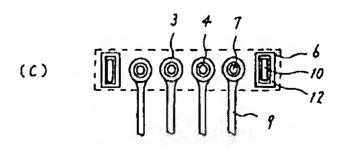
# (57)【要約】

【目的】 コネクタ基板の熱膨張に起因するコネクタ端 子の半田フィレットへのヒートサイクルによる応力を軽 減できるプリント基板用コネクタ装置を得る。

【構成】 コネクタ基板6にピン状のコネクタ端子7複 数を直線的に配置し固定してなるプリント基板用コネク タ14の、コネクタ端子6をプリント配線基板13に貫 通させプリント配線基板13のランド3と半田接続して 構成したプリント基板用コネクタ装置において、両外端 のコネクタ端子6の外側位置のコネクタ基板6にコネク タ端子6より断面積の大きい補強ピン10を固定し、補 強ピン10がプリント配線基板13を貫通してランド1 2に半田接続されている。







2:プリント基板基材

11:貫通穴(補強じゅ用)

3:ランド(コネクタ端子用)

12:ランド (補残ピン用)

6:コキクタ基板

13: アリント配鉄巻板

7: コキクタ 端子

14:プリント菱板用コネクタ

10:補強ピン

#### 【特許額求の範囲】

【請求項2】 補強ピンが雄ねじでなり半田はねじ部と接着していることを特徴とする請求項1に記載のプリント基板用コネクタ装置。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】この発明は、主にプリント配線基板に実装されるプリント基板用コネクタ装置に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】一般にプリント配線基板の形態分類において非スルーホールめっきとスルーホールめっきに大別できるが、ここでは非スルーホールめっきでのものに関して述べる。図5は従来のプリント基板用コネクタ装を示しており、(A)は実装後の断面図、(C)は(A)においてb矢方向に見た底面図を示す。図においるは紙基材フェノール樹脂等のプリント基板基材ではの表面にランド3を形成してなるプリント基板基材ではりまるでは例えばサイロン系樹脂等のコネクタ端子7複数を並列配置に固定してなるプリント基板用コネクタ、8はコネクタ端子7複数を並列配置に固定してなるプリント基板用コネクタ、8はコネクタ端子7で表表を接続する半田フィレット、9はプリント配線基板1の回路配線パターンを示す。

【0003】プリント基板用コネクタ5はプリント配線 基板1に設けられた貫通穴4に自動挿入装置、又は人に よりコネクタ端子7を貫通させて組み合わせられる。次 いで自動半田付装置又は半田ごてにおいて、ランド3と コネクタ端子7を半田付けし、半田フィレット8を形成 し回路配線パターン9と電気回路接続を完了する。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】従来のプリント基板用コネクタ5は、すべてのコネクタ端子7を電気回路として使用するように構成されている。図6は従来のプリント基板用コネクタ装置で使用環境上におけるコネクタの状態を示す断面図で、(A)は電源OFF時の状態、

(B) は電源ON時の状態を示している。電源ON時は、コネクタ基板6の線(熱) 膨張係数がプリント基板基材2のそれと比較して大きい(例えば4倍) ことか

ら、コネクタの中心部Xを境として矢印の方向に膨張 し、それに伴いコネクタ端子フも同一方向に引っ張られ る形となり、最終的に半田フィレット8へ応力が加わ る。実際には、プリント基板基材2にも同一方向に膨張 しているがここでは相対的な変化で図示している。ま た、電源OFF時は矢印と逆方向に応力が加わることに なり、この電源ON、OFFのヒートサイクルによる応 カが繰り返し半田フィレット8へ加わることにより、半 田フィレット8の亀裂が発生し最終的に破断に至り電気 回路機能を果さなくなる。図フは図6-(A)における 半田フィレット8を示すa部分拡大図で、亀裂の発生状 態を8aに、破断の発生状態を8bに示している。ヒー トサイクルにおける応力は、コネクタの両外端子部が中 央端子部より大きく影響を受けており、半田フィレット 8の亀裂8a及び破断8bは、コネクタ両外端子部に最 初発生している。また、半田フィレット8の破断86が 発生する過程において、特に高電圧部の回路では製品と して致命的な発火,発煙等の重大欠陥を導く要因となる 事もあり得るなどの問題点があった。

【0005】この発明は上記のような問題点を解消するためになされたもので、コネクタ基板の熱膨張に起因するコネクタ端子の半田フィレットへのヒートサイクルによる応力を軽減できるプリント基板用コネクタ装置を得ることを目的とする。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】この発明に係る請求項1のプリント基板用コネクタ装置は、コネクタ基板にピン状のコネクタ端子複数を直線的に配置し固定してなるプリント基板用コネクタの、コネクタ端子をプリント配線基板のランドと半田接続して構成したプリント基板用コネクタ装置において、両外端のコネクタ端子の外側位置のコネクタ基板にコネクタ端子より断面積の大きい補強ピンを固定し、補強ピンがプリント配線基板を貫通してランドに半田接続されているものである。

【0007】また、請求項2のプリント基板用コネクタ 装置は、請求項1において、補強ピンが雄ねじでなり半 田はねじ部と接着しているものである。

#### [0008]

【作用】この発明におけるプリント基板用コネクタ装置は、補強ピンがコネクタ基板の両端で線膨張係数の差により発生するコネクタ基板の熱膨張の応力をコネクタ端子より大きい断面積部に吸収し、コネクタ端子への応力を軽減させ半田フィレットの破断を防止する。

【0009】また、補強ピンを接続させる半田がねじ部と接着しているので、半田フィレットの接触面積を大きくとれ半田接続部の強化を可能にする。

### [0010]

# 【実施例】

実施例 1. 以下、この発明の実施例 1 を図について説明

する。図1はこの発明の突施例1におけるプリント基板 用コネクタ装置を示しており、(A)は突装後の断面側 面図、(B)は(A)においてb矢方向に見た平面図、 (C)は(A)においてc矢方向に見た底面図を示す。 図において、2~4、6~9は従来と同様でありその説 明は省略する。10はコネクタ端子6の両外側の並列位 置にコネクタ端子6より断面積の大きい形状この場合長 方形でコネクタ基板6に圧入固定されている補強ビン、 11はプリント基板基材2に設けられた補強ピン10を 貫通する貫通穴、12はプリント基板基材2に設けられ た補強ピン10用のランドを示し、2~4.11.12 でプリント配線基板13を、6、7、10でプリント基 板用コネクタ14を構成している。プリント基板用コネ クタ14がプリント配線基板13と組み合わせされ、コ ネクタ端子フが貫通穴4に通される際に、貫通穴11に 補強ピン10が貫通され、次いでコネクタ端子7の半田 付に合わせランド12と補強ピン10の先端が半田付さ れプリント基板用コネクタ装置が完成する。

【OO11】図2はこの実施例におけるプリント基板用コネクタ装置の動作状態を説明する断面図で、(A)は電源OFF時の状態、(B)は電源ON時の状態を示している。コネクタ基材6とプリント基板基材2の線

(熱) 膨張係数の違いによる半田フィレット8への応力は図2-(B) に示す様にコネクタ中心部Xを境として両外端へいく程、大きく影響を受けているが、その応力を電気回路上使用しない補強ピン10の半田フィレット8にて吸収しているので、電気回路として使用するコネクタ端子7への応力を軽減させることができ、電源ON、OFFのヒートサイクルによる応力に対応することが可能となる。

【0012】 実施例2. 上記実施例1ではコネクタ端子7の断面が円形状で補強ピンの断面が長方形状のものを示したが、実施例2として図3の(A)~(E)に示すように形状の組み合わせを変えて形成しても良い。

(A)は円形コネクタ端子7とそれより大きい円形補強ピン10aとを組み合わせプリント基板コネクタ14aとした例、(B)は正方形コネクタ端子7aとそれより大きい断面の円形補強ピン10aとを組み合わせプリント基板コネクタ14bとした例、(C)は正方形コネクタ端子7aとそれより大きい断面の長方形補強ピン10とを組み合わせプリント基板コネクタ14cとした例、

(D) は正方形コネクタ端子 7 a とそれより大きい断面 の正方形補強ピン 1 O b とを組み合わせプリント基板コネクタ 1 4 d とした例、(E) は円形コネクタ端子 7 とそれより大きい断面の正方形補強ピン 1 O b とを組み合わせプリント基板コネクタ 1 4 e とした例を示したものである。

【0013】実施例3.以下、この発明の実施例3を図について説明する。図4はこの発明の実施例3におけるプリント基板用コネクタ装置を示しており、(A)は実

装後の断面側面図、(B)は(A)においてb矢方向に見た平面図、(C)は(A)においてc矢方向に見た底面図を示す。図において、2~4、6~9は従来と同様でありその説明は省略する。15はコネクタ端子6の両外側の並列位置でコネクタ基板に圧入された雌ねじ付スペーサ、16は雌ねじ付スペーサに螺合しプリント基板基材2に設けられた雄ねじ16の貫通する貫通穴、18はプリント基板基材2に設けられた雄ねじ16のランドを示し、2~4、17、18でプリント配線基板19を、6、7、15、16でプリント基板用コネクタ20を構成している。

【0014】上記プリント配線基板19とプリント基板用コネクタ20を実施例1と同要領で組み合わせ、コネクタ端子7および雄ねじ16をランド3.18にそれぞれ半田付してプリント基板用コネクタ装置を完成させる。この構成によれば雄ねじ16の先端を形成するねじ部が半田付面積を実施例1の補強端子10に比較して大きくするため、半田フィレット8の破断までの寿命を延長できる。また、雄ねじ16は雌ねじ付スペーサ15と螺合することで容易に固定できる。

【0015】なお、この実施例3ではコネクタ端子7を 円形状としたが図3-(B)に示すような正方形コネク タ端子7aを使用するようにしてもよい。

[0016]

【発明の効果】以上のように、この発明の請求項1によれば、コネクタ基板にピン状のコネクタ端子複数を直線的に配置し固定してなるプリント基板用コネクタの、コネクタ端子をプリント配線基板に貫通させプリント配線基板のランドと半田接続して構成したプリント基板用コネクタ端子より断面積の大きい通知でコネクタ基板にコネクタ端子より断面積の大き関値といったのでロスクタ端子へのでカットに半田接続されているのでコネクタ端子への応うと軽減させ半田フィレットの破断が防止できる品質の高いプリント基板用コネクタ装置が得られる効果がある。【0017】また、この発明の請求項2によれば、請求

【0017】また、この発明の請求項2によれば、請求項1において、補強ピンが雄ねじでなり半田はねじ部と接着しているので、半田フィレットの接触面積を大きくとれ半田接続部の強化を可能にし信頼性を向上させる。 【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明の実施例1におけるプリント基板用コネクタ装置を示し、(A)は実装後の断面側図を、

- (B) は(A) においてb矢方向に見た平面図を、
- (C)は(A)においてc矢方向に見た底面図を示すものである。

【図2】 実施例1におけるプリント基板用コネクタ装置の動作状態を説明する断面図である。

【図3】 この発明の実施例2におけるプリント基板用 コネクタ装置の構成を示す平面図である。 【図4】 この発明の突施例3におけるプリント基板用コネクタ装置を示し、(A)は突装後の断面側図を、

- (B)は(A)においてb矢方向に見た平面図を、
- (C)は(A)においてc矢方向に見た底面図を示すものである。

【図5】 従来のプリント基板用コネクタ装置を示し、

(A)は実装後の断面側図を、(B)は(A)において b矢方向より見た平面図を、(C)は(A)において c 矢方向より見た底面図を示すものである。

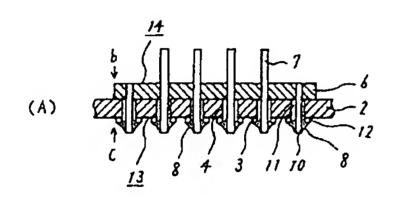
【図6】 従来のプリント基板用コネクタ装置の使用状況の状態を示す断面図である。

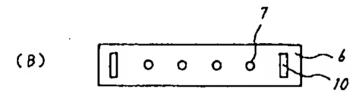
【図7】 図6における半田フィレットを部分拡大した断面図である。

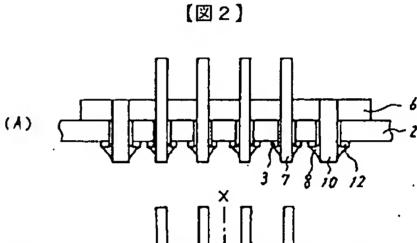
#### 【符号の説明】

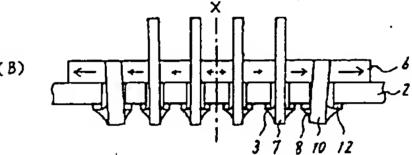
2 プリント基板基材、3 ランド(コネクタ端子 用)、6 コネクタ基板、7 コネクタ端子、10 補強ピン、11 貫通穴(補強ピン用)、12 ランド (補強ピン用)、13 プリント配線基板、14 プリント基板用コネクタ、15 雌ねじ付スペーサ、16 雄ねじ(補強ピン)、17 貫通穴(雄ねじ用)、18 ランド(雄ねじ用)、19 プリント配線基板、20 プリント基板用コネクタ。

【図1】









(C) 10 0 0 0 10 12

2:プリント基板基材 11:貫通穴(補強ピン用)

3:ランド(コネクタ端子用) 12:ランド (補強ピン用)
6:コネクタ基板 13:プリント配線基板
7:コネクタ端子 14:プリント基板用コネクタ

7:コキクタ嫡子 10:補強ピン 8b 7 8a 8

【図7】

[図3] [図4]

